

# HDF 硅专用切削液

## 产品用途

适用于单晶硅半导体材料的多线切割，单晶硅半导体的晶块内圆切削的润滑、降温、清洗防锈。

## 性能特点

- 1、极强的携载性能、悬浮性能；
- 2、克服了传统中性切削液单一机械作用的缺点，将化学劈裂作用与机械切割作用完美的结合在一起，作用力均一稳定，有效解决了切片工艺中的应力腐蚀问题，从而大幅度降低了损伤；
- 3、有效解决了切屑和切粒粉末的再沉积问题，避免了硅表面的化学键合吸附现象，便于硅片的清洗和后续加工；
- 4、散热效果好
- 5、无离子污染，有效消除金属离子尤其铁离子的污染；
- 6、良好的清洗渗透性能，可防止工具磨具钝化，对磨具具有良好的自锐作

用，提高工具的切削力，延长工具的使用寿命，缩短单个工件加工时间；

7、突出的润滑性能，明显降低切削工件时产生的噪音，减少划痕、表面粗糙、崩边、碎片等现象的出现，明显改善加工工件的表面质量，大幅度提高工件的光洁度。

8、良好的防锈性能，抗腐臭性能，产品稳定性好，使用寿命长；

9、水性环保产品；

### 理化指标

项目	指标
外观	透明液体
PH	>7
比重	>0.9
气味	低味

防锈性能 (35°C, 试片, 加速锈蚀, 周期)	144
抗磨润滑实验	通过

## 使用方法

- 1、使用新鲜水质或蒸馏水稀释使用；
- 2、一般切割：建议使用浓度：10—20%；
- 3、对于带磨料的研磨切削：建议高浓度使用，以现场工艺要求确定最佳使用

浓度。

## 注意事项

保持切削液的清洁，禁止混入金属切屑、机油、线毛等杂物；禁止用工作液洗手、洗抹布；严禁食用；远离儿童存放。